



muRata

株主・投資家の皆様へ 第77期中間報告書

平成24年4月1日 ▶ 平成24年9月30日

目次

ごあいさつ	1
製品別の売上概況	3
販売の状況	5
連結貸借対照表	7
連結損益計算書	8
連結キャッシュ・フロー計算書/個別業績の概要	9
株主還元	10
トピックス	11
会社概要/役員および執行役員	13
株式の状況/株式事務に関するご案内	14

Innovator in Electronics

muRata

株式会社 村田製作所

証券コード：6981

ごあいさつ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。第77期（平成25年3月期）の中間報告書をお届けするにあたり、当社グループの業績概要についてご報告申し上げます。

第2四半期連結累計期間の業績について

当第2四半期連結累計期間の世界の経済情勢は、財政問題に起因する欧州経済の低迷に加え、米国の雇用、住宅市場の低迷、中国やその他新興国の経済成長率鈍化などから、先行き不透明な状況で推移しました。

当社が属するエレクトロニクス市場におきましては、AV機器やパソコン、ハードディスクドライブ等の生産が振るいませんでしたが、当第2四半期に入ってスマートフォン、タブレット端末等の新製品の生産が本格的に立ち上がり、電子部品の需要が増加しました。

このような市場環境のもと、当社の当第2四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期連結累計期間比6.3%増の314,683百万円となりました。

利益につきましては、生産能力の増強や企業買収に伴

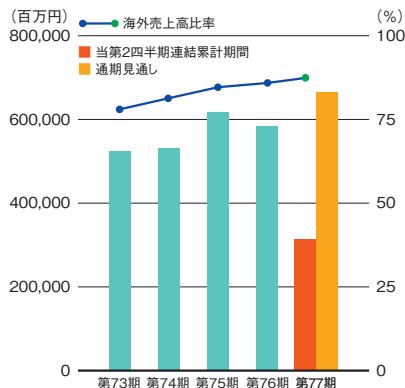
う固定費の増加、製品価格の値下がりや円高といった減益要因を、コストダウンで補うことができず、営業利益は前年同四半期連結累計期間比21.5%減の24,352百万円、税引前四半期純利益は同33.7%減の23,018百万円、四半期純利益は同36.1%減の15,129百万円となりました。

通期業績の見通し

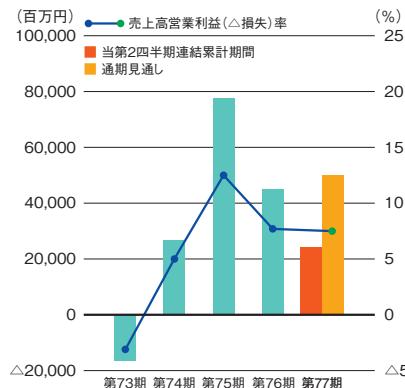
当社を取り巻く市場環境は、当第2四半期以降、スマートフォンやタブレット端末等の新製品の生産の立ち上がりにより部品需要が増加してきましたが、世界の経済情勢は引き続き低調であり、AV機器やパソコン等の生産は期初の予測を下回る見通しです。

当社は平成24年7月31日に業績見通しの修正を行った際、平成25年3月期の下半期の業績見通しにつきましては、欧州債務危機を発端とした世界的な景気の減速懸念、円高の長期化に伴う収益の悪化等により先行きが不透明な状況であったことから見直しを行っていませんでしたが、10月末日時点での部品需要見通しと、生産能力のさらなる増強や製品価格の値下がりといった減益要因を鑑

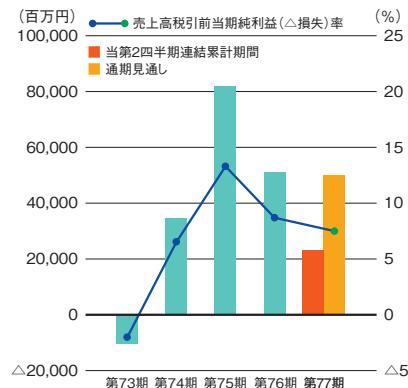
■売上高 / 海外売上高比率



■営業利益(△損失) / 売上高営業利益(△損失)率



■税引前当期純利益(△損失) / 売上高税引前当期純利益(△損失)率



み、平成25年3月期の業績見通しについて、売上高を665,000百万円（前連結会計年度比13.7%増）、営業利益を50,000百万円（同11.2%増）、税引前当期純利益を50,000百万円（同1.8%減）、当期純利益を33,000百万円（同7.1%増）と修正いたしました。

株主還元策について

株主の皆様への利益還元策としては、配当による成果の配分を優先的に考え、長期的な企業価値の拡大と企業体質の強化を図りながら、1株当たり利益を増加させることにより配当の安定的な増加に努めることを基本方針としております。この方針に基づき、連結ベースでの業績と配当性向並びに内部留保の蓄積などを総合的に勘案したうえで、配当による利益還元を行っております。

また、当社は自己株式の取得につきましても株主の皆様への利益還元策としてとらえており、資本効率の改善を目的に適宜実施しております。

中間配当金は、当上半期の業績だけではなく内部留保の蓄積を鑑み、期初に予定していたとおり、1株当たり

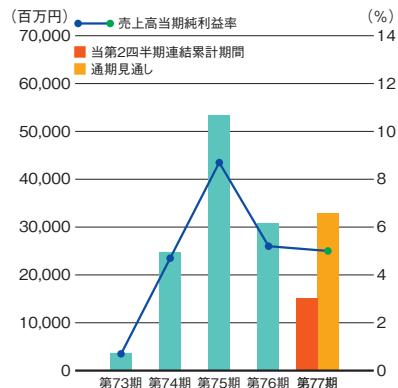
50円とさせていただきます。また、当期末配当金につきましても、中間配当金と同様の1株当たり50円とし、年間配当金は100円を予定しております。なお、この1株当たり配当金は、10月末日時点の事業環境及び通期の業績見通しによるものです。

（注）業績予想の前提条件及び注意事項については当社第2四半期決算短信6、7ページをご参照ください。第2四半期決算短信は当社ホームページでもご覧いただけます。

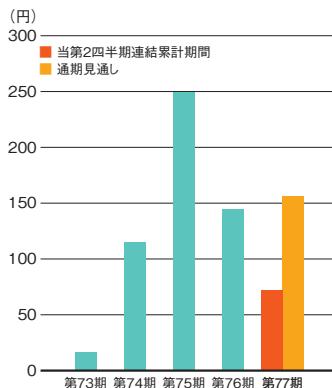


代表取締役社長 村田恒夫

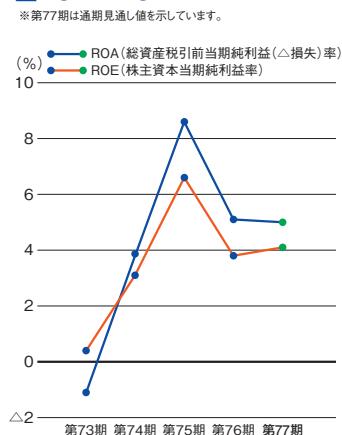
■ 当期純利益 / 売上高当期純利益率



■ 1株当たり当期純利益



■ ROA / ROE



製品別の売上概況

当第2四半期連結累計期間の製品別の売上高を前年同四半期連結累計期間と比較した概況は、以下のとおりです。

コンポーネント

当第2四半期連結累計期間のコンポーネントの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ3.6%増の214,257百万円となりました。

コンデンサ

この区分には、積層セラミックコンデンサなどが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、主力のチップ積層セラミックコンデンサが、カーエレクトロニクス向けで自動車の生産台数増に加え電装化の進展により大幅な増加となったほか、タブレット端末向けも好調でしたが、AV機器や家電・その他向けが振るわず、全体では微増となりました。その他のコンデンサは、AV機器や家電・その他向けが不振でした。

その結果、コンデンサの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ0.9%減の108,885百万円となりました。

圧電製品

この区分には、表面波フィルタ、発振子、圧電センサ、セラミックフィルタなどが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、表面波フィルタが、高周波回路のモジュール化の進展から通信モジュールセグメント向けの社内取引の割合が高まった影響等で減少しました。発振子は、カーエレクトロニクス、携帯電話向けが好調でした。

その結果、圧電製品の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ1.9%減の38,822百万円となりました。

その他コンポーネント

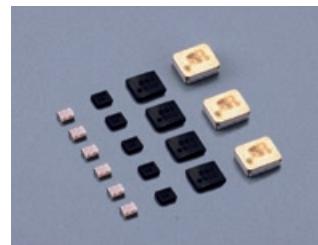
この区分には、EMI除去フィルタ、コイル、コネクタ、サーミスタ、センサなどが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、EMI除去フィルタが、携帯電話向けで好調でしたが、薄型テレビと基地局向けで振るいませんでした。コイルは、携帯電話、タブレット端末、カーエレクトロニクス向けの高周波回路用コイルが伸び、大きく増加しました。コネクタは、携帯電話、タブレット端末向けで大幅に増加しました。センサは、買収したVTI Technologies OyのMEMS (Micro Electro Mechanical Systems) センサが加わったことから、前年同四半期連結累計期間を大幅に上回りました。

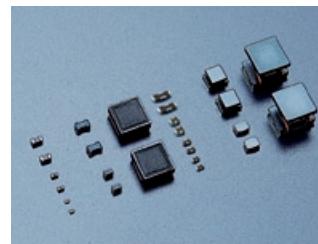
その結果、その他コンポーネントの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ16.0%増の66,550百万円となりました。



チップ積層セラミックコンデンサ



表面波フィルタ



チップフェライトビーズ/
チップ共通モードチョークコイル/
エミフィル®/チップコイル

モジュール

当第2四半期連結累計期間のモジュールの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ12.9%増の99,208百万円となりました。

通信モジュール

この区分には、近距離無線通信モジュール、多層デバイス、通信機器用モジュールなどが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、近距離無線通信モジュールが、スマートフォン、タブレット端末向けに好調でしたが、携帯メディアプレイヤー、従来型携帯電話向けが振るわず、全体では前年同四半期連結累計期間を下回りました。多層デバイスは、携帯電話、タブレット端末向けに大きく伸びました。通信機器用モジュールは、スマートフォン向けに大幅に伸長したことに加え、ルネサス エレクトロニクス株式会社から買収したパワーアンプ事業が加わったことから、前年同四半期連結累計期間を大きく上回りました。

その結果、通信モジュールの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ20.9%増の75,541百万円となりました。

電源他モジュール

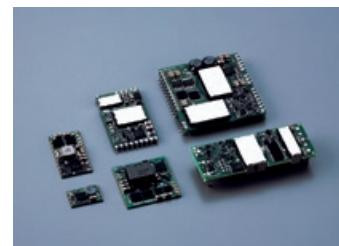
この区分には、電源などが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、電源が、カーエレクトロニクス向けに好調でしたが、その他の用途で振るわず、全体では減少となりました。

その結果、電源他モジュールの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ6.7%減の23,667百万円となりました。



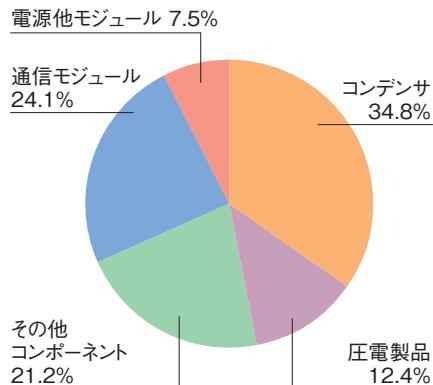
無線LAN向けモジュール
(Wi-Fiモジュール)



DC-DCコンバータ

販売の状況

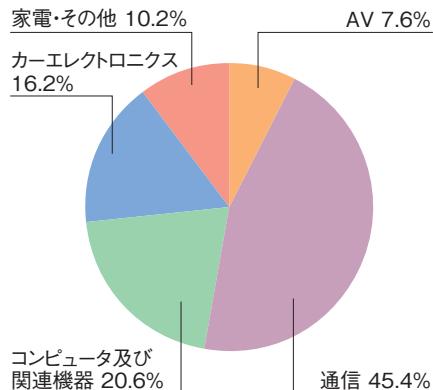
製品別売上高



(単位:百万円)

期別 項目	前第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日 ~平成23年9月30日)		当第2四半期 連結累計期間 (平成24年4月1日 ~平成24年9月30日)		増減	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	増減率 (%)
コンデンサ	109,899	37.3	108,885	34.8	△1,014	△0.9
圧電製品	39,567	13.4	38,822	12.4	△745	△1.9
その他コンポーネント	57,395	19.5	66,550	21.2	9,155	16.0
コンポーネント計	206,861	70.2	214,257	68.4	7,396	3.6
通信モジュール	62,494	21.2	75,541	24.1	13,047	20.9
電源他モジュール	25,362	8.6	23,667	7.5	△1,695	△6.7
モジュール計	87,856	29.8	99,208	31.6	11,352	12.9
製品売上高計	294,717	100.0	313,465	100.0	18,748	6.4

用途別売上高 (当社推計値に基づいております)

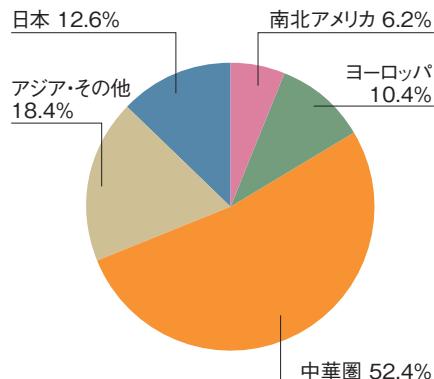


(単位:百万円)

期別 項目	前第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日 ~平成23年9月30日)		当第2四半期 連結累計期間 (平成24年4月1日 ~平成24年9月30日)		増減	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	増減率 (%)
AV	32,572	11.1	23,829	7.6	△8,743	△26.8
通信	127,393	43.2	142,232	45.4	14,839	11.6
コンピュータ及び関連機器	56,902	19.3	64,475	20.6	7,573	13.3
カーエレクトロニクス	39,843	13.5	50,870	16.2	11,027	27.7
家電・その他	38,007	12.9	32,059	10.2	△5,948	△15.6
製品売上高計	294,717	100.0	313,465	100.0	18,748	6.4

(単位:百万円)

地域別売上高



項目	前第2四半期 連結累計期間 <small>(平成23年4月1日 ～平成23年9月30日)</small>		当第2四半期 連結累計期間 <small>(平成24年4月1日 ～平成24年9月30日)</small>		増減	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
南北アメリカ	21,887	7.4	19,488	6.2	△2,399	△11.0
ヨーロッパ	34,871	11.8	32,599	10.4	△2,272	△6.5
中華圏	141,626	48.1	164,273	52.4	22,647	16.0
アジア・その他	54,567	18.5	57,677	18.4	3,110	5.7
海外計	252,951	85.8	274,037	87.4	21,086	8.3
日本	41,766	14.2	39,428	12.6	△2,338	△5.6
製品売上高計	294,717	100.0	313,465	100.0	18,748	6.4

用語解説

■コンデンサ (3ページ)

コンデンサは電気を蓄える働きをし、電源の電圧変動を吸収して電子機器の安定動作に貢献する役割を担う部品です。携帯電話、パソコン、デジタル家電など、多くの電子機器に使われています。

■フィルタ (表面波/セラミック/EMI除去) (3ページ)

コーヒーのフィルタでイメージできるように、必要な信号だけを通し、不要な信号を通さない働きをします。表面波フィルタ、セラミックフィルタは特定の信号だけを通す役割をし、EMI除去フィルタは信号に含まれるノイズ (EMI=Electromagnetic Interference) を除去して電子回路を守ります。

■発振子 (3ページ)

電子機器にはプロセッサやマイコンなどのデジタルICが多数使われています。発振子は、それらのデジタル信号処理を正しく動作させるために、テンポを制御する「基準クロック信号」を発生させる電子部品です。

■サーミスタ (3ページ)

サーミスタとは、温度により抵抗値が変化するセラミックの抵抗体です。電子機器の小型化・高出力化が年々進む中、機器の機能だけでなく、機器の安全性・安定性対策にサーミスタ機能のニーズが高まっており、過熱検知・過電流保護・温度補償などの用途に展開されています。

■MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) (3ページ)

半導体の微細加工技術を用いて作製された微小な部品から構成される電気機械システムです。ジャイロセンサや加速度センサ等に応用されています。

■多層デバイス (4ページ)

従来は1枚の基板上に多数の部品を実装して構成していた回路を、セラミックシートを何層も重ねて形成した多層セラミックスの内部に3次元で回路を構成し、部品の機能を作り込むことによって、小型化を実現した電子部品です。

■パワーアンプ (Power Amplifier) (4ページ)

携帯電話等において高周波信号を送信するときに、同信号を増幅させる働きをする部品です。

連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	期別 前連結会計年度末		期別 当第2四半期 連結会計期間末	
	(平成24年3月31日)		(平成24年9月30日)	
	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)	(1,000,885)	(100.0)	(1,007,393)	(100.0)
流動資産	431,850	43.1	447,567	44.4
現金及び預金	54,460		43,859	
短期投資	25,391		29,774	
①有価証券	64,215		51,236	
受取手形	915		763	
②売掛金	122,175		143,561	
貸倒引当金	△761		△710	
③たな卸資産	132,037		150,966	
繰延税金資産	16,927		17,910	
前払費用及びその他の流動資産	16,491		10,208	
有形固定資産	304,934	30.5	317,267	31.5
土地	46,512		46,541	
建物及び構築物	284,023		285,847	
機械装置及び器具備品	627,961		655,626	
建設仮勘定	26,131		21,565	
減価償却累計額	△679,693		△692,312	
投資及びその他の資産	264,101	26.4	242,559	24.1
関連会社に対する投資	2,070		2,182	
①投資	195,773		174,789	
のれん	11,741		13,373	
繰延税金資産	10,002		9,730	
その他の固定資産	44,515		42,485	
合計	1,000,885	100.0	1,007,393	100.0

(単位:百万円)

科目	期別 前連結会計年度末		期別 当第2四半期 連結会計期間末	
	(平成24年3月31日)		(平成24年9月30日)	
	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)	(192,343)	(19.2)	(202,663)	(20.1)
流動負債	121,445	12.1	131,572	13.1
短期借入金	30,392		40,252	
買掛金	36,940		34,408	
未払給与及び賞与	21,998		22,377	
未払税金	2,712		8,244	
未払費用及びその他の流動負債	29,403		26,291	
固定負債	70,898	7.1	71,091	7.0
長期債務	6,804		7,101	
退職給付引当金	62,303		62,454	
繰延税金負債	535		317	
その他の固定負債	1,256		1,219	
(資本の部)	(808,542)	(80.8)	(804,730)	(79.9)
資本金	69,377		69,377	
資本剰余金	102,396		102,396	
利益剰余金	743,206		747,781	
その他の包括損失累計額	△43,373		△51,757	
有価証券未実現損益	1,044		1,352	
年金負債調整勘定	△4,687		△4,542	
デリバティブ未実現損益	△527		21	
為替換算調整勘定	△39,203		△48,588	
自己株式(取得原価)	△63,064		△63,067	
合計	1,000,885	100.0	1,007,393	100.0

Point

前連結会計年度末からの主な増減要因

①「有価証券」(△12,979百万円)及び「投資」(△20,984百万円)の減少

主に債券の償還があったことによるものです。

②「売掛金」(21,386百万円)の増加

需要の増加により、売上高が増加したことによるものです。

③「たな卸資産」(18,929百万円)の増加

主に下半期のスマートフォン向け需要に対し、先行して在庫を積み増したことによるものです。

連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	期別		前第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年9月30日)		当第2四半期 連結累計期間 (平成24年4月1日～平成24年9月30日)	
			金額	百分比	金額	百分比
				%		%
売上高			295,906	100.0	314,683	100.0
売上原価			203,351	68.7	222,793	70.8
販売費及び一般管理費			41,494	14.0	44,381	14.1
研究開発費			20,037	6.8	23,157	7.4
営業利益			31,024	10.5	24,352	7.7
受取利息及び配当金			2,592	0.8	1,854	0.5
支払利息			△34	△0.0	△137	△0.0
為替差損益			966	0.3	△1,719	△0.5
その他(純額)			171	0.1	△1,332	△0.4
税引前四半期純利益			34,719	11.7	23,018	7.3
法人税等			12,468	4.2	8,001	2.5
(法人税、住民税及び事業税)			(11,138)		(10,271)	
(法人税等調整額)			(1,330)		(△2,270)	
持分法投資利益			1,418	0.5	112	0.0
四半期純利益			23,669	8.0	15,129	4.8

Point

売上高は、AV機器やパソコン、ハードディスクドライブ等の生産が振るいませんでしたが、第2四半期に入ってスマートフォン、タブレット端末等の新製品の生産が本格的に立ち上がり、電子部品の需要が増加し、全体では、前年同四半期連結累計期間比6.3%増の314,683百万円となりました。営業利益につきましては、生産能力の増強や企業買収に伴う固定費の増加、製品価格の値下がりや円高といった減益要因を、コストダウンで補うことができず、前年同四半期連結累計期間比21.5%減の24,352百万円となりました。税引前四半期純利益は同33.7%減の23,018百万円、四半期純利益は同36.1%減の15,129百万円となりました。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
		(平成23年4月1日～平成23年9月30日)	(平成24年4月1日～平成24年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		17,851	9,099
投資活動によるキャッシュ・フロー		△8,523	△23,566
財務活動によるキャッシュ・フロー		△4,912	966
換算レート変動による影響		△1,212	△284
現金及び現金同等物の増加(△減少)額		3,204	△13,785
現金及び現金同等物の期首残高		63,020	65,302
現金及び現金同等物の四半期末残高		66,224	51,517

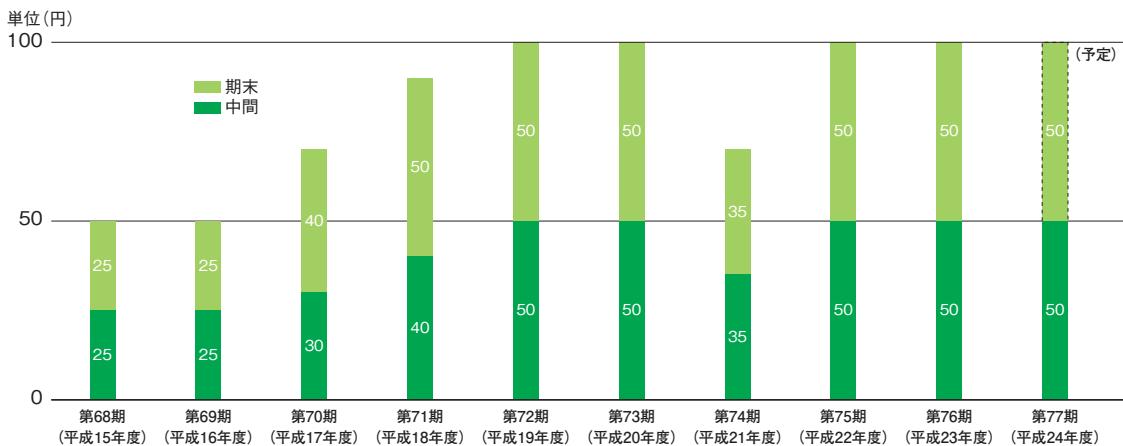
個別業績の概要

(単位:百万円)

科 目	期 別	前第2四半期累計期間	当第2四半期累計期間
		(平成23年4月1日～平成23年9月30日)	(平成24年4月1日～平成24年9月30日)
売上高		255,001	257,845
営業利益		3,751	518
経常利益		11,518	9,384
四半期純利益		10,504	9,562
総資産		611,231	590,561
純資産		402,273	383,491
1株当たり四半期純利益(円)		48.94	45.31

株主還元

■ 1株当たり配当金の推移



■ 自己株式の取得

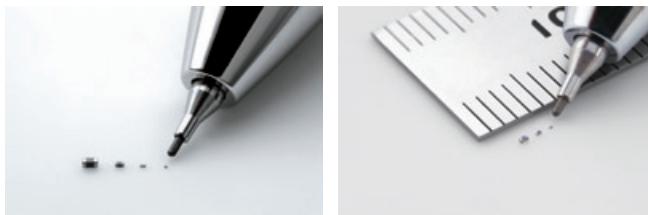
当社は資本効率の改善を目的に自己株式の取得を適宜実施しており、平成14年～平成23年の10年間で167,857百万円、33,272千株の自己株式を取得し、これまでに19,000千株を消却しました。

世界初、世界最小 積層セラミックコンデンサ・チップインダクタ 0201サイズ (0.25×0.125mm) の開発

スマートフォンをはじめとする小型モバイル機器の高機能化により、電子部品の搭載点数がますます増加し、高密度実装を支える超小型部品へのニーズが高まっています。そうしたなか、当社では、世界最小0201サイズ (0.25×0.125mm) の積層セラミックコンデンサとチップインダクタを開発しました。どちらも、現在一部のスマートフォンに搭載されている0402サイズ (0.4×0.2mm) より体積比約75%ダウンを実現しました。2013年度内のサンプル出荷に向けて開発を進めています。

積層セラミックコンデンサはあらゆる電子機器の中に搭載され、最新のスマートフォンには400～500個搭載されているといわれています。高周波用チップインダクタにおいても、これまでの最小サイズである0402サイズは、高周波モジュールを中心に採用が広がっています。

* インダクタ：コンデンサや抵抗器とともに電子回路の基本となる部品で、コイルとも呼ばれています。「高周波用インダクタ」は、電気信号を伝える回路で主にインピーダンスマッチングやフィルタとして使われます。



0201サイズの積層セラミックコンデンサ (左) とチップインダクタ (右)

世界最小、低消費電流 スマートフォン用送信モジュールの量産開始について

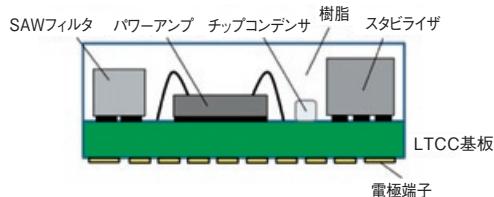
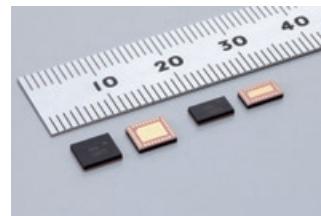
LTE対応や多機能化により、携帯電話・スマートフォンの搭載部品点数や消費電流が増加する傾向にあるなかで、高周波回路部では、よりコンパクトな設計や、消費電流の抑制が求められています。当社では、世界で初めてSAWフィルタ^{*1}、パワーアンプ^{*2}、スタビライザ^{*3}を1パッケージにした携帯電話用送信モジュールを開発・量産して大好評を得てきました。今回、この送信モジュールにLTCC^{*4}基板を用いて多層化し、多層構造部分に周辺の部品を組み込むことで、従来品に比べ実装面積を50%削減しました。また、スタビライザを内蔵することで、携帯電話・スマートフォンの使用環境変動時の消費電流を最大約20%抑制することに成功しました。今年8月より量産を開始しています。

*1 SAWフィルタ：特定の周波数帯域の信号を取り出すための素子。

*2 パワーアンプ (Power Amplifier)：携帯電話等において高周波信号を送信するときに、同信号を増幅させるはたらきをします。

*3 スタビライザ (Magnetic Stabilizer)：アイソレータの中に使われる磁石で、アンテナに人の手や金属が近づくときに起こるインピーダンス変動による特性変動を抑制します。

*4 LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics)：低温同時焼成セラミックス。通常の電子セラミックスより焼成温度が低いいため、内層配線に導体抵抗の低い銀や銅を使うことが可能となります。



福祉用具総合メーカー 株式会社幸和製作所と 電動歩行アシストカー「KeePace (キーパス)」を共同開発

企業・技術PRロボットとして開発した、自転車型ロボット「ムラタセイサク君[®]」や一輪車型ロボット「ムラタセイコちゃん[®]」の"止まっても倒れない技術"を応用し、昨年のCEATEC JAPAN 2011にてコンセプトモデルを出展しました。そしてこの度、ご高齢の方、足腰が不自由な方向けの歩行補助車として、国内シルバーカーシェア50%を占める福祉用具の総合メーカー、株式会社幸和製作所と電動歩行アシストカー「KeePace (キーパス)」を共同開発しました。当製品は、今年のCEATEC JAPAN 2012でも展示・デモンストレーションを行い、多くの方々より関心を寄せていただきました。

当社製MEMSジャイロセンサ^{*1}や傾斜センサ^{*2}、倒立振子制御技術^{*3}等を組込んだ「アシスト制御システム」の進化により、坂道での歩行サポートや旋回機能が飛躍的に向上しました。

^{*1} MEMSジャイロセンサ：傾きや曲がりの変化を検知する角速度センサ。カーナビゲーションシステムにおいては、自動車の進行方向の変化を検出することで現在地を特定する役割を果たします。

^{*2} 傾斜センサ：傾斜角度を計測するセンサ。「KeePace」には今年1月に買収を完了したMurata Electronics Oy製傾斜センサを搭載。

^{*3} 倒立振子制御技術：ロボットが自身の傾きを検知し、倒れる方向に車体を移動することにより転倒を防ぐバランス制御技術。



八日市事業所開所50周年 — 「次なる飛躍」を目指して大凧を飛ばし—

八日市事業所（滋賀県東近江市）は、セラミックス原料の開発から生産、窯業、最終製品としての加工までフルスペックの機能を有する、当社で唯一の拠点です。増大するセラミックコンデンサの需要に対応するため、新しい設備や工法を導入した新鋭工場として1962年に操業を開始し、今年で開所50周年を迎えました。その記念行事として、20畳敷の大凧を製作し、5月27日に開催された「東大江大凧まつり」のオープニングで披露しました。

東近江大凧は、「判じ文」（凧の意味）が特徴の一つです。八日市事業所では、開所50周年という節目を、これまでの50年に感謝し、次の50年（100周年）を目指す第2の開所元年と位置付け、「次なる飛躍（100）」をキャッチフレーズとしており、これを凧の図柄で表現しました。「八日市事業所50周年 次なる飛躍へ」という判じ文に今後の発展への想いを込めて、参加した従業員約50名で見事に飛ばせました。



- 商号 株式会社 村田製作所
Murata Manufacturing Co., Ltd.
- 設立 昭和25年12月23日（創業 昭和19年10月）
- 資本金 69,377百万円
- 従業員数 連結 37,637名 個別 7,191名
- 所在地 本社 〒617-8555京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 電話 075-951-9111
支社 東京支社・東京都渋谷区
事業所 長岡事業所・京都府長岡京市/八日市事業所・滋賀県東近江市/野洲事業所・滋賀県野洲市/横浜事業所・横浜市緑区
営業所 仙台/水戸/さいたま/東京/立川/浜松/名古屋/安曇野/京都/神戸/岡山/福岡
- 国内関係会社 24社
- 海外関係会社 53社

役員および執行役員

平成24年9月30日現在

■ 代表取締役

取締役社長 村田 恒夫
取締役副社長 藤田 能孝

■ 取締役

村田 恒夫
藤田 能孝
家木 英治
牧野 孝次
棚橋 康郎（社外取締役）
吉原 寛章（社外取締役）

■ 監査役

常勤監査役 中山 素彦
吉野 幸夫
監査役 豊田 正和（社外監査役）
中西 倭夫（社外監査役）
西川 和人（社外監査役）

■ 執行役員

常務執行役員 家木 英治
牧野 孝次
濱地 幸生
執行役員 西村 昌雄
小島 祐一
井上 亨
問所 新一
岡田 剛和
中島 規巨
藺田 聡
岩坪 浩
前川 利弘
竹村 善人
鴻池 健弘
丸山 英毅
多田 裕
石谷 昌弘
水野 健一
石野 聡
酒井 範夫

フェロー

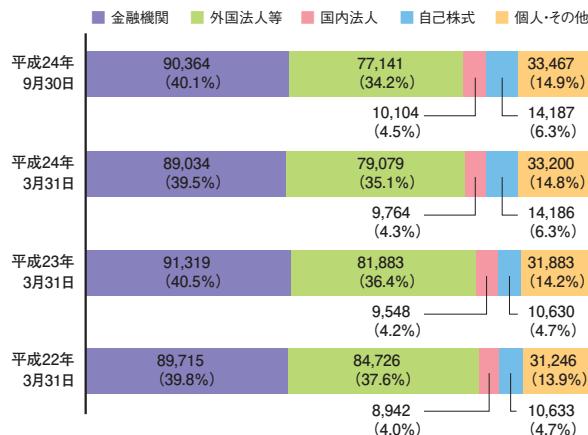
■ 株式事項

発行済株式総数 225,263千株
株主数 80,890名

■ 株式上場

[国内] 東京証券取引所 市場第一部
大阪証券取引所 市場第一部
[海外] シンガポール証券取引所

■ 所有者別分布状況(千株)



■ 大株主の状況

順位	株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
1	日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	11,827	5.6
2	ジェーピー・モルガン・チェース バンク 380055	11,353	5.4
3	日本生命保険相互会社	9,201	4.4
4	日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	8,490	4.0
5	ステート・ストリート・バンク アンド・トラスト・カンパニー	5,635	2.7
6	株式会社京都銀行	5,260	2.5
7	明治安田生命保険相互会社	5,240	2.5
8	SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS	4,382	2.1
9	株式会社滋賀銀行	3,551	1.7
10	株式会社みずほコーポレート銀行	3,000	1.4

(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式(14,187千株)を除いて計算しております。

株式事務に関するご案内

■ お取扱窓口

証券会社に口座をお持ちの場合

お手続きお問い合わせ先 お取引のある証券会社
お手続き内容 住所変更、名義変更、単元未満株式の買取請求、配当金受取り方法のご指定、相続に伴うお手続き等

証券会社等に口座をお持ちでない場合(特別口座の場合)

お手続きお問い合わせ先 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-288-324(通話料無料)
<お取扱店> みずほ信託銀行株式会社 本店および全国各支店
みずほインバスターズ証券株式会社 本店および全国各支店
(みずほインバスターズ証券は、平成25年1月4日以降はみずほ証券となります。)
お手続き内容 住所変更、名義変更、単元未満株式の買取請求、配当金受取り方法のご指定、相続に伴うお手続き等
特別口座での留意事項 特別口座では、株式の売却はできません。
売却するには、証券会社にお取引の口座を開設し株式の振替手続きが必要となります。

■ 未払い配当金のお支払い

上記のお取扱店に加え、株式会社みずほ銀行 本店および全国各支店で承ります。

※当社では単元未満株式の買取に関する手数料を無料としておりますので、ぜひご活用ください。

(お取引証券会社等で株式を管理している場合は、お取引証券会社等で別途手数料のかかる場合がございます。)

株 主 メ モ

■ 事業年度

毎年4月1日から翌年3月31日まで

■ 剰余金の配当基準日

中間配当金 9月30日

期末配当金 3月31日

■ 単元株式数

100株

■ 公告の方法

当社ウェブサイトに掲載いたします。

(<http://www.murata.co.jp/>)

ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

■ 株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社

■ 事務取扱場所

大阪市北区曾根崎二丁目11番16号

みずほ信託銀行株式会社 大阪支店証券代行部

■ 郵便物送付／電話お問い合わせ先

〒168-8507

東京都杉並区和泉二丁目8番4号

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

0120-288-324（通話料無料）

《復興特別所得税に関するお知らせ》

東日本大震災の復興財源を確保するための復興特別所得税が導入されたことに伴い、平成25年1月1日以降に支払いが開始される配当金については、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が追加的に課税されます。（今回の中間配当金は復興特別所得税の課税の対象にはなりません。）

		～平成24年12月31日まで	平成25年1月1日～ 平成25年12月31日	平成26年1月1日～ 平成49年12月31日
上場株式等の配当等に 係る税金と税率	所得税	7%	<u>7.147%</u>	<u>15.315%※</u>
	住民税	3%	3%	5%※
合 計		10%	<u>10.147%</u>	<u>20.315%</u>

平成25年1月以降の所得税率の計算方法



平成25年1月～平成25年12月 ⇒ $7\% + 7\% \times 2.1\% = 7.147\%$
平成26年1月～ ⇒ $15\% + 15\% \times 2.1\% = 15.315\%$

※平成25年12月31日をもって、上場株式等の配当・譲渡所得税等に係る軽減税率の適用終了が予定されています。



Innovator in Electronics

muRata

株式会社 村田製作所